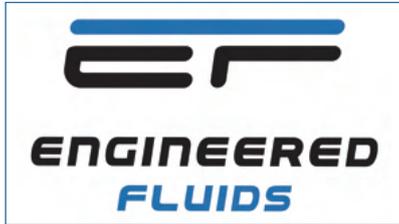


# DTT61-s

## 液浸冷却用熱伝導シート



LiPOLY DTT61-s は、液浸冷却環境でのギャップフィリング用途に設計した熱伝導材料です。Engineered Fluids 社による材料適合性試験において、最高レベルの認証を取得しております。熱伝導率は 6.0 W/m\*K と高く、優れた柔軟性と絶縁性を備えており、設計時の公差を補償しながら、長期にわたり安定した性能を提供します。また、カスタム形状への対応も可能です。

### ■ 製品の特性

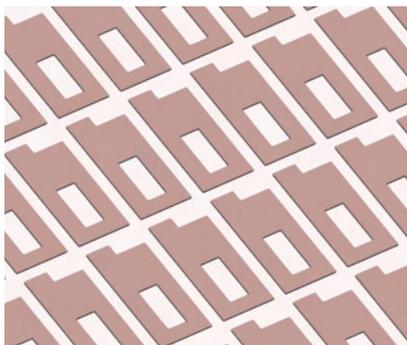
- / 熱伝導率：6.0 W/m\*K
- / 自然な粘着性があり、製造工程での取り扱いが容易
- / 低い熱抵抗
- / 豊富な厚みバリエーションを提供可能

### ■ 製品アプリケーション

- / サーバーにおける单相式液浸冷却
- / ゲーミングPC
- / AIコンピューティング装置
- / ソリッドステートドライブ (SSD)
- / ヒートパイプアセンブリ
- / メモリモジュール
- / パワーアンプ

### ■ 製品の形

- / ロール状 / シート状
- / フォーミング形



### ■ 代表特性

物理特性	DTT61-s	試験方法	単位
色	Red	Visual	-
表面粘着性 (2面 / 1面)	2	-	-
厚さ	Customized	ASTM D374	mm
密度	3.3	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>
使用温度	-60~200	-	°C
ROHS & REACH	Compliant	-	-
<b>圧縮特性@1.0mm</b>			
圧縮率 @10 psi	4	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @20 psi	5	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @30 psi	8	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @40 psi	14	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @50 psi	19	ASTM D5470 modify	%
<b>電気特性</b>			
絶縁破壊電圧	8	ASTM D149	KV/mm
表面抵抗率	>10 <sup>11</sup>	ASTM D257	Ohm
体積抵抗率	>10 <sup>10</sup>	ASTM D257	Ohm-m
<b>熱特性</b>			
熱伝導率	6.0	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10psi	0.387	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@20psi	0.375	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@30psi	0.356	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@40psi	0.333	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@50psi	0.317	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W

### 熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率

